

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2024-005

上海硅产业集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员及其他核心管理人员
增持公司股份计划
暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事/总裁邱慈云先生、执行副总裁/董事会秘书李炜先生、财务副总裁/财务负责人黄燕女士及其他核心管理人员计划自2024年2月6日起6个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等）增持公司股份，本次合计拟增持金额不低于人民币600万元且不超过人民币1,200万元。
- 公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。
- 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，

基于对公司未来前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，公司将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。主要措施包括：

一、董事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份计划

（一）增持主体基本情况

1、增持主体：董事/总裁邱慈云先生，执行副总裁/董事会秘书李炜先生、财务副总裁/财务负责人黄燕女士及公司其他核心管理人员。

2、截至本公告披露日，董事/总裁邱慈云先生直接持有公司股份 2,333,334 股，占公司总股本 0.08%；执行副总裁/董事会秘书李炜先生直接持有公司股份 1,256,000 股，占公司总股本 0.05%；财务副总裁/财务负责人黄燕女士直接持有公司股份 203,334 股，占公司总股本 0.01%。

3、本公告披露之前 12 个月内，上述增持主体均未披露过增持计划。

（二）增持计划主要内容

1、本次拟增持股份的目的

增持主体为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，拟增持公司股份。

2、本次拟增持股份的金额

本次拟增持股份金额合计不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,200 万元。

具体如下：

	增持主体姓名	职务	拟增持金额区间（万元）	
			下限	上限
1	邱慈云	董事、总裁	240	480
2	李炜	执行副总裁、董事会秘书	160	320
3	黄燕	财务副总裁、财务负责人	80	160
4	其他核心管理人员	其他核心管理人员	120	240
合计			600	1,200

3、本次拟增持股份的价格

本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。

4、本次增持股份计划的实施期限

本次增持公司股份计划拟自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内完成。

5、本次拟增持股份的资金安排

增持主体拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。

6、本次拟增持股份的方式

增持主体拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等）增持公司股份。

（三）增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

（四）其他说明

1、增持主体承诺在实施增持公司股份计划的过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行披露义务。

二、专注公司经营，提升核心竞争力

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。公司自成立以来，坚持面向国家半导体行业的重大战略需求，坚持全球化布局，坚持紧跟国际前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术。

经过持续的努力，硅产业集团目前已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业，产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前产品类型涵盖 300mm 抛光片及外延片、200mm 及以下抛光片及外延片、SOI 硅片、压电薄膜衬底材料等，产品广泛应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率

器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。

至 2023 年，子公司上海新昇正在实施的新增 30 万片/月 300mm 半导体硅片产能建设项目实现新增产能 15 万片/月，公司 300mm 半导体硅片合计产能已达到 45 万片/月；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下抛光片、外延片合计产能超过 50 万片/月；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下 SOI 硅片合计产能超过 6.5 万片/月。

后续，公司将持续把扩大生产规模、丰富产品结构、持续提高市场占有率作为公司业务的重要战略任务，争取在保持国内领先地位的基础上，把握当前市场机遇，进一步提升国际综合竞争力。

三、加快募投项目建设

公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

四、加强与投资者的沟通

公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将继续积极参加上海证券交易所组织的各类业绩说明会，并持续通过“e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等各种形式，加强与投资者的沟通、交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年2月6日